

# 北京国化新材料技术研究院有限公司文件

---

## 关于召开“2026（第二十八届）有机硅精细 化学品技术交流会”的预通知

### 各有关单位：

“十四五”规划纵深推进，以新能源汽车、新能源、储能、医疗健康、可穿戴设备、个人护理为代表的战略性新兴产业正以前所未有的速度重塑全球产业链格局。作为不可或缺的关键材料，有机硅正迎来技术爆发与市场应用的“黄金时代”。新场景催生新需求，新需求牵引新突破，如何把握产业脉搏，抢占技术制高点，已成为全行业共同关注的焦点。

为此，我院拟定于2026年4月13-15日在苏州举办“2026（第二十八届）有机硅精细化学品技术交流会”。本届大会将以“创新驱动，跨界融合，赋能未来”为主题，设立“新能源汽车用有机硅、新能源与储能用有机硅、医疗健康与个人护理”三大热门主题。汇聚行业顶尖智慧，共同探讨有机硅材料的创新应用与技术前沿。报名本会，可免费参加“2026亚洲硅业科技大会及展览会”系列活动及“2026化工新材料及精细化工大会暨展览会ACMIE2026”系列活动。具体通知如下：

### 一、组织机构

支持单位:中国氟硅有机材料工业协会、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会、硅产业绿色发展联盟 SAGSI、中关村光伏产业联盟 ZPVA、云南省硅工业工程研究中心

主办单位:北京国化新材料技术研究院

承办单位:ACMI 硅材料发展中心、ACMI 硅基新材料研究所

支持媒体:有机硅、气凝胶产业、ACMI 硅基新材料、ACMI 光伏新材料、国化新材料研究院、化工新材料、硅产业绿色发展联盟官网

二、暂定日程

(一) 时间地点:

会议时间: 2026 年 4 月 13-15 日

会议地点: 江苏苏州

会议场地: 苏州狮山国际会议中心

场地地址: 江苏省苏州市虎丘区金山东路 78 号

(二) 会议议程:

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 月 13 日全天    | 注册、签到、展览                                                                                                           |
| 4 月 14 日上午    | 大会主论坛                                                                                                              |
| 4 月 14 日下午    | 主题一: 新能源汽车用有机硅                                                                                                     |
| 4 月 15 日上午    | 主题二: 新能源与储能用有机硅                                                                                                    |
| 4 月 15 日下午    | 主题三: 医疗健康与个人护理                                                                                                     |
| 报名本会<br>可免费参加 | 2026 亚洲硅业科技大会及展览会 AST2026:<br>1、2026 国际先进热管理材料技术交流会<br>2、2026 (第三届) 高纯石英材料技术及应用高峰论坛<br>3、2026 (第二届) 气凝胶制品新技术新应用交流会 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会 ACMIE2026:<br>1. FMC2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会<br>2. 2026 (第三届)液冷技术创新与市场应用论坛<br>3. 2026 半导体关键材料与应用技术交流会<br>4. 2026 钙钛矿电池技术与应用交流会<br>5. 2026 (第十五届)环氧树脂高端应用技术交流会<br>6. 2026 有机胺及改性胺产业论坛<br>7. 烯·聚 2026 乙烯下游高端聚合物发展研讨会<br>8. 2026 (第六届)丙烯酸酯及甲甲酯产业链发展论坛暨丙烯酸酯高端应用交流会<br>9. 2026 (第十二届)表面活性剂高端应用技术交流会<br>10. 特塑·热点 2026 (第二届)特种工程塑料产业峰会<br>11. 2026 年辐射固化创新发展论坛<br>12. 2026 年电子胶技术与应用创新发展论坛 |
| 4 月 13-15 日<br>展览会 | 2026 亚洲硅业科技大会及展览会<br>2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会 ACMIE2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 三、收费标准

#### (一) 参会费用

| 日期           | 1 人      | 2 人      | 3 人及以上   |
|--------------|----------|----------|----------|
| 3 月 15 日前    | 2800 元/人 | 2500 元/人 | 2200 元/人 |
| 3 月 15 日后及现场 | 3200 元/人 | 2900 元/人 | 2600 元/人 |

学生半价。费用含会议费、餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。

汇款账户信息（请注明“有机硅会议”）：

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456

## （二）商务合作

会议接受赞助发言、展位、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝、客户对接等各类商务合作，详询会务组。

## 四、联系方式

唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn

徐静涛 13916891739 xujingtao@acmi.org.cn

张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn

附件 1：参会回执表

附件 2：分论坛及暂定议题

附件 3：同期其他活动日程

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二五年十二月三日



## 附件 1:

## 参 会 回 执 表

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 会议名称后打✓                                                                                            | 2026（第二十八届）有机硅精细化学品技术交流会                                                                                                                                                             |          |          |          |
| 企业*<br>(发票抬头)                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
| 经营产品                                                                                               | (限添 3 种, 将录入通讯录中)                                                                                                                                                                    |          |          |          |
| 通讯地址*                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |          |          | 邮 编      |
| 参会代表                                                                                               | 姓 名                                                                                                                                                                                  | 职 务      | 手 机      | 电子邮箱     |
| 详细信息*                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |
| 参会费用                                                                                               | 日期                                                                                                                                                                                   | 1 人      | 2 人      | 3 人及以上   |
|                                                                                                    | 3 月 15 日前                                                                                                                                                                            | 2800 元/人 | 2500 元/人 | 2200 元/人 |
|                                                                                                    | 3 月 15 日后及现场                                                                                                                                                                         | 3200 元/人 | 2900 元/人 | 2600 元/人 |
|                                                                                                    | ____万 ____仟 ____佰 ____拾 ____元 ￥: ____元<br>(含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: 有机硅大会)                                                                                                                |          |          |          |
| 付款方式                                                                                               | 户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司<br>开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行<br>账 号: 0200 2282 0902 0125 456<br>汇款请注明“有机硅大会”                                                                                  |          |          |          |
| 住宿信息*                                                                                              | (签到时间 X 月 XX 日, 会议时间 X 月 XX-XX 日)<br>住宿时间: ____月 ____日至 ____月 ____日 共 ____天, 单间 ____间, 标间 ____间,<br>因会议人数较多, 房间有限, 会务组仅为付费代表提前预留房间, 房费请与酒店直接结算; 留房截止日期 4 月 15 日; 未支付会议费的代表, 住宿请自行安排。 |          |          |          |
| 会务组                                                                                                | 唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn<br>徐静涛 13916891739 xujingtao@acmi.org.cn<br>张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn                                                              |          |          |          |
| 提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组 (以上一人即可), 以便制作通讯录等资料;<br>发票种类 (打✓): 电子专票 ____; 电子普票 ____。<br>开票资料: |                                                                                                                                                                                      |          |          |          |



## 附件 2：分论坛及暂定议题

### 主题一：新能源汽车用有机硅

近五年我国新能源汽车用有机硅市场现状及趋势

动力电池的“守护神”：有机硅灌封胶如何解决热失控安全难题？

高导热有机硅结构胶在电池包与电驱系统的“多任务”角色

有机硅在传感器封装与智能座舱中的创新应用

下一代电池包轻量化密封与缓冲材料的未来

陶瓷化硅橡胶在高压线缆防火安全中的应用

有机硅密封胶在车门、车窗及电池包应对极端气候的解决方案

有机硅弹性体在新能源汽车减震与声学控制中的应用

新能源汽车用有机硅材料技术壁垒与国产化替代路径

新能源汽车高压线束用低烟无卤阻燃有机硅材料

液态硅橡胶（LSR）在智能车灯密封与光学透镜中的精密注塑技术前沿

硅胶发泡材料在提升驾乘舒适性与座椅轻量化的关键难题

高透光有机硅封装胶如何提升车载激光雷达与摄像头的可靠性

生物基有机硅在新能源汽车中的探索与未来

自修复有机硅在新能源汽车关键部件上的应用前瞻与商业化路径

导热硅脂与相变硅脂在电机控制器散热中的技术演进

高导热有机硅材料提升三合一电驱系统效能的要点

有机硅皮革在内饰应用中的抗污、抗菌、亲肤触感与耐久性平衡之道

有机硅皮革在生产制造、涂层复合等环节的技术壁垒与创新

电驱系统用高导热灌封硅凝胶的耐电化学腐蚀与耐久性研究

有机硅发泡垫片在电池包舱体与模块间的防火密封与缓冲解决方案

有机硅复合材料在汽车线束电磁屏蔽中的应用探索与性能评估

## 主题二：新能源与储能用有机硅

中国新能源与储能用有机硅现状及发展趋势

光伏组件用高耐候有机硅密封胶的性能升级与可靠性评估

有机硅在光伏背板涂层中的抗紫外与耐湿热技术

锂电池热管理用高导热有机硅灌封材料的研发与应用

耐电解液腐蚀的氟硅橡胶在动力电池密封系统中的解决方案

有机硅材料在氢燃料电池双极板涂层与密封件中的应用研究

有机硅发泡材料在 NVH 阻尼与电池缓冲垫片中的创新应用

有机硅密封胶在光伏电站接线盒、逆变器中的长效防护方案

光伏接线盒与逆变器用有机硅灌封胶的工艺优化与成本控制

有机硅包覆材料在锂电池正极材料改性中的最新进展

有机硅材料在固态电解质/电极界面修饰中的潜力与挑战

有机硅材料在新能源设备轻量化与集成化设计中的作用

光伏跟踪系统用高性能有机硅润滑材料的应用与维护

可回收与低 VOC 有机硅材料在新能源制造中的实践案例

有机硅界面改性技术在提高光伏转换效率中的应用

政策驱动下的高压平台、电池安全与热管理材料标准演进及行业机遇

域控制器与自动驾驶芯片的高效有机硅热界面材料选型方案

有机硅在储能电池包防火、隔热失控中的关键技术

氢燃料电池堆用有机硅垫片的耐久性与密封性能提升

有机硅在储能系统（ESS）中的导热、绝缘与防护综合方案

有机硅在集装箱式储能中的系统级解决方案

有机硅材料如何保障储能电芯 20 年以上的环境耐久性

废旧电池与光伏组件中有机硅材料的回收技术与商业化路径

探索膨胀型有机硅材料在电池包中“主动防御”机制的创新与应用

有机硅粘结剂解决硅碳负极体积膨胀难题的技术进展与产业化前景

### 主题三：医疗健康与个人护理

我国医疗健康与个人护理用有机硅市场现状及趋势

医疗级液态硅橡胶在精密医疗器械中的成型与应用

可穿戴医疗传感器用柔性导电有机硅胶的制备与信号稳定性

用于智能服饰的有机硅弹性纤维与织物的集成技术

医疗级有机硅的低毒、耐消毒与可灭菌解决方案

医疗级液态硅橡胶在介入导管与精密器械中的成型技术突破

有机硅凝胶在疤痕护理与皮肤修复中的临床应用

有机硅在可穿戴医疗监测设备中的柔性封装技术

医用级有机硅弹性体在仿生假肢与康复外骨骼中的应用

有机硅微球在药物载体与靶向治疗中的研究进展

高透氧有机硅材料在人工角膜与眼内植入物中的应用

有机硅在口腔修复材料（义齿软衬、印模材料）中的性能优化

自修复有机硅在长期植入器械表面保护中的应用

有机硅在医用透气膜与防护材料中的关键技术

亲水性有机硅在隐形眼镜材料中的性能提升

医用有机硅 3D 打印的技术壁垒与临床应用前景

化妆品用有机硅的温和性与皮肤屏障保护机制

有机硅在防晒、彩妆与护发产品中的配方创新

低 VOC 与可持续有机硅在个人护理产品中的应用趋势

可降解与生物基有机硅在医疗与日化领域的新进展

有机硅在药物控释与透皮贴剂中的关键作用

有机硅弹性体在护肤品中的肤感调控与绿色配方趋势

有机硅在香氛与除臭产品中的缓释与稳定技术

低刺激有机硅在婴幼儿护理产品中的安全应用



附件 3：同期其他活动日程

|                       |                           |                                                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4 月 13 日全天            | 注册、签到、展览                  | 一层大厅                                                   |
| 4 月 14 日上午            | 2026 化工新材料及精细化工大会暨展览会主论坛  | 全体代表                                                   |
| 4 月 14 日下午<br>-15 日全天 | 2026（第二届）亚洲有机硅技术交流会（闭门会议） | 主题一：亚洲各地有机硅宏观趋势<br>主题二：有机硅技术前沿与未来应用场景                  |
|                       | 2026（第二十八届）有机硅精细化学品技术交流会  | 主题一：新能源汽车用有机硅<br>主题二：新能源与储能用有机硅<br>主题三：医疗健康与个人护理       |
|                       | 2026 国际先进热管理材料技术交流会       | 主题一：热界面材料<br>主题二：新型导热材料<br>主题三：高导热封装材料                 |
|                       | 2026（第三届）高纯石英材料技术及应用高峰论坛  | 主题一：高纯石英提纯工艺及综合利用<br>主题二：高纯石英前沿技术<br>主题三：石英制品加工工艺及终端应用 |
|                       |                           |                                                        |
|                       |                           |                                                        |

|  |                                |                                                         |
|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 2026（第二届）气凝胶制品新技术新应用交流会        | 主题一：气凝胶材料与制品创新<br>主题二：建筑与工业保温用气凝胶制品<br>主题三：新能源、储能用气凝胶制品 |
|  | FMC2026(第十四届)氟材料高端应用及相关加工技术研讨会 | 主题一：电子信息与半导体<br>主题二：高端氟材料加工技术与装备创新<br>主题三：医疗健康与含氟新药     |
|  | 2026（第三届）液冷技术创新与市场应用论坛         | 主题一：液冷材料与关键部件<br>主题二：系统解决方案<br>主题三：液冷技术趋势               |
|  | 2026 半导体关键材料与应用技术交流会           | 主题一：光刻胶<br>主题二：湿电子化学品<br>主题三：电子气体                       |
|  | 2026 钙钛矿电池技术与应用交流会             | 主题一：钙钛矿材料技术创新<br>主题二：钙钛矿应用与产业化                          |
|  |                                |                                                         |
|  |                                |                                                         |
|  |                                |                                                         |
|  |                                |                                                         |
|  |                                |                                                         |

|  |                                          |                                                     |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 2026（第十五届）环氧树脂高端应用技术交流会                  | 主题一：特种环氧树脂<br>主题二：耐温/增韧树脂<br>主题三：阻燃环氧材料<br>主题四：复合材料 |
|  | 2026 有机胺及改性胺产业论坛                         | 有机胺、改性胺                                             |
|  | 烯·聚 2026 乙烯下游高端聚合物发展研讨会                  |                                                     |
|  | 2026（第六届）丙烯酸酯及甲甲酯产业链发展论坛暨<br>丙烯酸酯高端应用交流会 | 丙烯酸、特种酯 SAP 树脂、MMA、丙烯酸树脂/<br>乳液/胶黏剂                 |
|  | 2026（第十二届）表面活性剂高端应用技术交流会                 |                                                     |
|  | 特塑·热点 2026（第二届）特种工程塑料产业峰会                | 尼龙、聚酰亚胺                                             |
|  | 2026 年辐射固化创新发展论坛                         | 光固化、辐射固化、UV 固化                                      |
|  | 2026 年电子胶技术与应用创新发展论坛                     | 电子胶粘剂                                               |
|  | “走出去”研讨会                                 | 全球主要化工园区介绍                                          |
|  |                                          |                                                     |
|  |                                          |                                                     |
|  |                                          |                                                     |